

证券代码：002916

证券简称：深南电路

深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-34

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 其他（ <u>券商策略会</u> ）
参与单位名称及人员姓名（排名不分先后）	博时基金、长信基金、招商基金、东北证券自营、汇丰晋信基金、华安基金、平安基金、大成基金、申万宏源证券
时间	2023年11月16日
地点	申万宏源证券策略会举办地（深圳）
上市公司接待人员姓名	战略发展部总监、证券事务代表：谢丹
投资者关系活动主要内容介绍	<p>交流主要内容：</p> <p>Q1、请介绍公司 2023 年第三季度经营情况。</p> <p>2023 年第三季度，公司把握行业需求的局部修复机会，盈利能力环比有所改善。公司在第三季度实现营业收入 34.28 亿元，环比增长 5.50%，归母净利润 4.34 亿元，环比增长 62.33%，扣非归母净利润 3.12 亿元，环比增长 26.29%。上述变动主要得益于公司把握封装基板业务下游部分需求恢复的机会，营收规模环比有所增长；同时，公司内部精益改善工作持续开展，运营能力获得进一步提升，助益毛利率环比略有增长。此外，公司在本期内收到部分政府补助款项，助益归母净利润环比增长。</p> <p>Q2、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。</p> <p>公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产品下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并长期深耕工控医疗等领域。下游应用分布情况较今年上半年未发生重大变化。</p> <p>Q3、请介绍公司 PCB 业务在通信领域拓展情况。</p>

公司 PCB 业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧及有线侧通信 PCB 产品。2023 年前三季度，通信市场整体需求未明显改善。在市场环境带来的挑战下，公司凭借行业领先的技术与高效优质的服务，在现有客户群中实现订单份额稳中有升，并持续加大力度推进新客户开发工作；此外，公司也将继续关注和研究行业技术演进趋势，根据行业需求做好相应技术储备。

Q4、请介绍公司 PCB 业务在数据中心领域拓展情况。

数据中心作为公司近年来新进入并重点拓展的领域之一，已对公司营收产生较大贡献，整体市场份额有待公司进一步拓展。公司已配合客户完成 EGS 平台用 PCB 样品研发并具备批量生产能力，现已逐步进入中小批量供应阶段。公司 AI 服务器相关 PCB 产品目前占比较低，对营收贡献相对有限。2023 年前三季度，由于全球经济降温和 EGS 平台切换不断推迟，数据中心整体需求依旧承压，公司该领域 PCB 订单同比有所减少。2023 年第三季度，数据中心领域下游部分客户项目订单有所回补，公司将继续聚焦拓展客户并积极关注和把握 EGS 平台后续逐步切换带来的机会。

Q5、请介绍公司 PCB 业务在汽车电子领域拓展情况。

汽车电子是公司 PCB 业务重点拓展领域之一。公司以新能源和 ADAS 为主要聚焦方向，主要生产高频、HDI、刚挠、厚铜等产品，其中 ADAS 领域产品比重相对较高，应用于摄像头、雷达等设备，新能源领域产品主要集中于电池、电控层面。2023 年前三季度，公司持续加大对汽车电子市场开发力度，积极把握新能源和 ADAS 方向带来的增长机会，前期导入的新客户定点项目需求已逐步释放，同时深度开发现有客户项目贡献增量订单，南通三期工厂产能爬坡顺利推进为订单导入提供产能支撑，汽车电子领域报告期内营收规模同比继续实现增长，占 PCB 整体营收比重有所提升。

Q6、请介绍公司封装基板业务在下游市场拓展情况。

公司封装基板业务产品覆盖种类广泛多样，包括模组类封装基板、存储类封装基板、应用处理器芯片封装基板等，主要应用于移动智能终端、服务器/存储等领域。2023 年第三季度，受消费电子等下游市场需求局部修复影响，公司各类封装基板订单环比有所增长。公司凭借自身广泛的 BT 类封装基板产品覆盖能力，积极导入新项目，开发新客

	<p>户，特别在存储类、射频模组类、FC-CSP 类产品市场取得深耕成果。同时，公司在 FC-BGA 封装基板的技术研发与客户认证工作均按期有序推进。</p> <p>Q7、请介绍公司目前在 FC-BGA 封装基板技术研发与客户认证方面取得的进展。</p> <p>公司 FC-BGA 封装基板中阶产品目前已在客户端顺利完成认证，部分中高阶产品已进入送样阶段，高阶产品技术研发顺利进入中后期阶段，现已初步建成高阶产品样品试产能力。</p> <p>Q8、请介绍公司广州封装基板项目的建设连线进展。</p> <p>公司广州封装基板项目主要面向 FC-BGA 封装基板、RF 封装基板及 FC-CSP 封装基板三类产品。项目共分两期建设，其中项目一期已于 2023 年 10 月下旬连线，目前处于产线初步调试阶段。</p> <p>Q9、请介绍公司无锡基板二期工厂连线后产能爬坡进展。</p> <p>相较于常规 PCB 工厂，封装基板工厂需要构建起适应国际半导体产业链客户要求的生产、质量、经营等高效运营体系，产能爬坡周期较长。公司无锡基板二期工厂已于 2022 年 9 月下旬连线投产并进入产能爬坡阶段，产线能力得到持续验证与提升，目前产能利用率达到四成。</p> <p>注：调研过程中公司严格遵照《信息披露管理制度》等规定，未出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件清单	无
日期	2023 年 11 月 16 日